

ELECTROCONDUCTIVES

DOTITE

For Plastic PKG

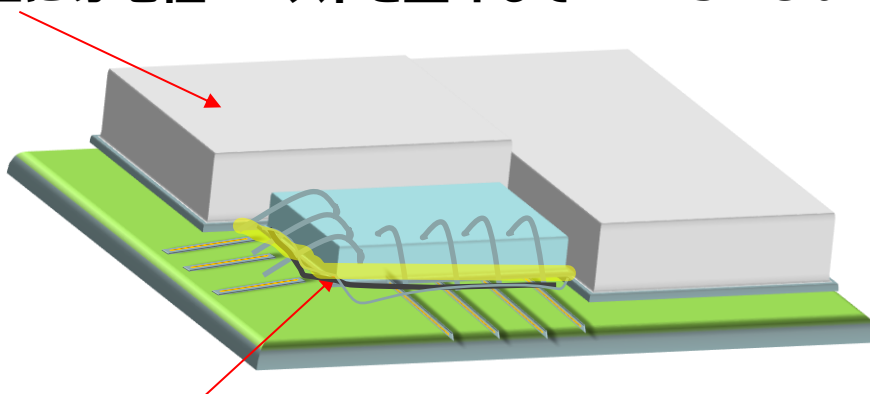
材料種：電磁波シールド材料
 用途：モールド樹脂上塗布
 特徴：多種塗布・工法対応
 例)真空印刷・スプレー・
 スピンコート



材料種：導電性接着剤
 用途：メタルキャップと-基板間の導通
 半導体PKGの基板への実装
 特徴：高接着性・塗膜柔軟性

Package Level EMI Shielding

EMC上に導電性ペーストを塗布してEMI Shieldingが可能



ダイアタッチ材、TIM等他部位でも放熱材料として使用可能

放熱用途向材料

材料種：ダイアタッチペースト
 (導電性、非導電性)
 用途：半導体PKGダイアタッチ向け
 特徴：高信頼性

材料種：銀シンタリングペースト
 フルシンタ(加圧・無加圧)
 ハーフシンタのラインナップ
 用途：パワー半導体ダイアタッチ向
 TIM
 特徴：高熱伝導性、高耐熱性



【硬化条件】250℃, 10MPa, 5min (真空中)

